

技术参数

5923

日期：06/2026

应用介绍

特点

一款单组份环氧树脂胶，低温固化快，粘度适中，适用于电子元器件密封粘接，尤其适用热敏感器件的粘接。

粘接材料

金属，陶瓷，塑料/PCB，玻璃等

典型应用

电子元器件材料密封和粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	6110	20rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件*	10mins@80℃	
有效期@-20℃,月	6	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	84D	ASTM D-2240
玻璃化温度 Tg	44℃	
热膨胀系数	$\alpha_1 = -4.6 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ ($< T_g$) $\alpha_2 = 145.8 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ ($> T_g$)	
耐水浸泡 (40℃)	6 天未开胶	PI 膜粘接
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围*	-55℃—180℃	

储存和使用方法

产品需低于-20℃环境中保存，真空包装，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

1. 本技术数据表(TDS)中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

